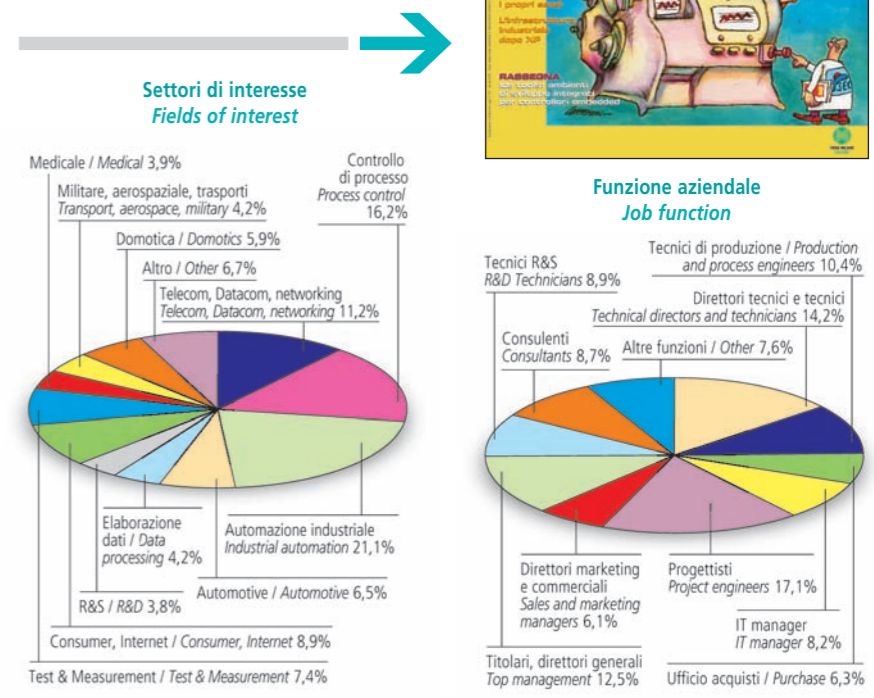




NUMERO ISSUE	SPECIALE COVER STORY	APPROFONDIMENTI IN DEPTH	ARTICOLI GENERALI GENERAL ISSUES	FOCUS ON FOCUS ON	EDIZIONI ON LINE ON LINE EDITION	FIERE EXHIBITIONS
29 Febbraio February	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi e moduli DSP (DSP systems and modules) 	<ul style="list-style-type: none"> Trend dei RTOS (RTOS trends) Standard per schede - aggiornamenti (Boards standard - update) Sistemi per applicazioni gravose (System for harsh environment applications) 	<ul style="list-style-type: none"> Sicurezza nelle applicazioni embedded (Security in embedded application) Computer rugged (Rugged computers) 	<ul style="list-style-type: none"> Difesa/aerospazio (Defense/aerospace) 	<ul style="list-style-type: none"> Web Exclusive: Gestire l'obsolescenza dei componenti (Component obsolescence) 	<p>NI Days, febbraio, Milano</p> <p>Real Time and Embedded Computing Conference, febbraio, 0Atlanta (GA-USA) / Huntsville (AL-USA) / Melbourne (FL-USA)</p> <p>ICQNM 2009 - The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, 01-06/02, Cancun (MEX)</p> <p>MC* Motion Control, febbraio, (I)</p> <p>Real Time and Embedded Computing Conference Marzo, Dallas / Houston (TX-USA)</p> <p>Embedded World, 03-05/03, Norimberga (D)</p> <p>CeBIT, 03-08/03, Hannover (D)</p> <p>Smart Systems Integration, 10-11/03, Bruxelles (B)</p> <p>EMV, 10-12 /03, Stoccarda (D)</p> <p>PCIM China, 17-19/03, Shanghai (RPC)</p>
30 Aprile April	<ul style="list-style-type: none"> PXI, LXI, VXI (PXI, LXI, VXI) 	<ul style="list-style-type: none"> Soluzioni di sicurezza e biometria (Security solution and biometrics) Schede di I/O (I/O boards) Microcontrollori per applicazioni embedded (Microcontrollers for embedded applications) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi operativi open-source (Open source operating systems) Domotica (Domotics) Reti di sensori wireless (Wireless sensor networks) 	<ul style="list-style-type: none"> Il mercato della distribuzione in Italia (Italian Distribution Market) 	<ul style="list-style-type: none"> Web Exclusive: Progettazione per l'efficienza energetica (Designing for energy efficiency) 	<p>Embedded Systems Conference - Silicon Valley 14-18/04, San Jose (CA-USA)</p> <p>Display, 15-17/04, Tokyo (J)</p> <p>Hannover Messe, 20-24/04, Hannover (D)</p> <p>DATE, 20-24/04, Nizza (F)</p> <p>SMT Hybrid Packaging, 05-07/05, Norimberga (D)</p> <p>PCIM Europe, 12-14/05, Norimberga (D)</p> <p>Enermotive, 26-30/05, Fieramilano (Rho-MI)</p> <p>LinvinLuce, 26-30/05, Fieramilano (Rho-MI)</p>
31 Giugno June	<ul style="list-style-type: none"> Evoluzione dei RTOS (RTOS evolution) 	<ul style="list-style-type: none"> VoIP e standard multimediali (VoIP and multimedial standards) Visualizzazione industriale (Industrial vision) Schede mezzanino (Mezzanine cards) 	<ul style="list-style-type: none"> Architetture multicore/multiprocessore (Multicore/multiprocessor architecture) Riutilizzo del software (Software reuse) Standard per schede - aggiornamenti (Boards standard - update) 	<ul style="list-style-type: none"> Trasporti (Transportation) 	<ul style="list-style-type: none"> Web Exclusive: Produrre in Italia: problemi e prospettive (Manufacturing in Italy Pros&cons) 	<p>VforM-Vision for Manufacturing, giugno</p> <p>Laser World of Photonics, 15-18/06, Monaco (D)</p> <p>European Automotive Components Expo, 16-18/06, Stoccarda (D)</p> <p>NI Week, agosto, Austin (TX-USA)</p>
32 Settembre September	<ul style="list-style-type: none"> Motherboard per applicazioni industriali (Motherboards for industrial applications) 	<ul style="list-style-type: none"> Applicazioni medicali (Medical applications) Architetture degli SBC (SBC architectures) 	<ul style="list-style-type: none"> Applicazioni militari/aerospaziali (Military/Aerospace applications) DSP/FPGA ed elaborazione riconfigurabile (DSPs, FPGAs, Programmable boards) Software open source (Open source software) 	<ul style="list-style-type: none"> Reti wireless industriali (Industrial wireless network) 	<ul style="list-style-type: none"> Web Exclusive: Embedded: make or buy (Make or buy in embedded) 	<p>C²-Control & Communication, settembre</p> <p>Embedded System Conference, settembre, Boston (MA-USA)</p> <p>Nanoforum, settembre, Milano (I)</p> <p>Microelettronica, 01-03/10, Vicenza (I)</p> <p>Semicon Europe, 06-08/10, Stoccarda (D)</p> <p>SAME, 07-08/10, Sophia Antipolis (F)</p>
33 Novembre November	<ul style="list-style-type: none"> Tool di debug (Debugging tools) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistemi/schede FPGA (FPGA boards/systems) Programmazione parallela (Parallel programming schemes) Applicazioni per microTCA (MicroTCA applications) 	<ul style="list-style-type: none"> Standard per schede - aggiornamenti (Boards standard - update) Sistemi e schede di simulazione (Simulation boards and systems) Componenti resistenti alle radiazioni (Rad-hard components) 	<ul style="list-style-type: none"> Mercati embedded emergenti (Emerging embedded markets) Guida/repertorio: Sistemi embedded 	<ul style="list-style-type: none"> Web Exclusive: Trend nell'Embedded Computing Technology (ECT trends) 	<p>Focus Embedded, novembre</p> <p>Productronica, 10-13/10, Monaco (D)</p> <p>SPS/IPC/Drives, 24-26/11, Norimberga (D)</p>

CHI LEGGE ELETTRONICA OGGI EMBEDDED READERS OF ELETTRONICA OGGI EMBEDDED



Formati	Formats	Euro 4/c	Euro b/n b/w
1/4 pagina	1/4 page	880,00	646,00
1/3 pagina	1/3 page	1.027,00	823,00
1/2 pagina	1/2 page	1.996,00	1.351,00
2/3 pagina	2/3 page	2.231,00	1.645,00
Pagina	Page	2.767,00	2.055,00
Pagina pos. speciale	Special position page	2.878,00	2.138,00
I copertina	Front cover	8.244,00	-
EB incontra	EB incontra	8.083,00	-
I romana	Third page	3.212,00	3.212,00
Doppia mezza	Double half page	3.993,00	2.701,00
II copertina	Inside front cover	3.439,00	-
III copertina	Inside back cover	2.846,00	-
IV copertina	Back cover	5.039,00	-
Doppia pagina	Double page	5.534,00	4.111,00
Cartolina	Post card	1.800,00	1.800,00
Battente cop.	Cover leaf	6.522,00	-
Inserto 2 facciate	Insert 2 front	2.500,00	2.500,00
Inserto 4 facciate	Insert 4 front	4.100,00	4.100,00
Supplemento colore	Colour supplement	+20%	+20%
Posizioni speciali	Special position	+15%	+15%

Guida/Repertorio Guide/Directory		Euro 4/c	Euro b/n b/w
Formati	Formats	Euro 4/c	Euro b/n b/w
Pagina	Page	1.468,00	1.283,00
I romana	Third page	1.845,00	1.688,00
I copertina	Front cover	4.192,00	-
II copertina	Inside front cover	2.396,00	-
III copertina	Inside back cover	2.095,00	-
IV copertina	Back cover	2.994,00	-
Doppia pagina	Double page spread	2.995,00	2.397,00

Prenotazione degli spazi: 45 gg prima della data di uscita
Space booking: 45 days before publication date

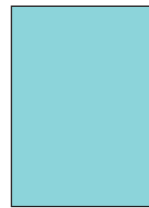
Consegna materiale: 35 gg prima della data di uscita
Delivery material: 35 days before publication date

Periodicità	Frequency	Data pubblicazione	Issue date	Tipo di stampa	Printing process
5 numeri/anno	5 issues a year	1° settimana del mese	First week of each month	Offset piana	Web offset

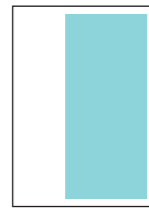
FORMATI PUBBLICITARI ADVERTISING FORMATS

AUTOMAZIONE OGGI
FIELD BUS & NETWORKS
ELETTRONICA OGGI
ELETTRONICA OGGI EMBEDDED
RMO - Rivista di Meccanica Oggi

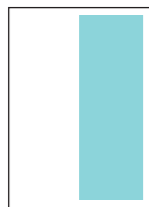
SdA - Soluzioni di Assemblaggio
PROGETTARE
FLUIDOTECNICA
INQUINAMENTO
RICH-MAC CHIMICA NEWS
ENERGIE OGGI



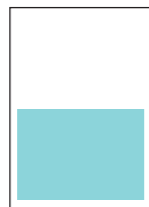
PAGINA INTERA
FULL PAGE
210 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
190 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



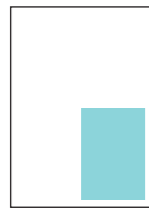
2/3 PAG. VERTICALE
IN GABBIA
2/3 PAGE VERTICAL
(TYPE AREA)
118 X 260 mm



1/2 PAG. VERTICALE
HALF PAGE VERTICAL
100 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
90 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



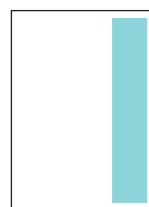
1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE HORIZONTAL
210 X 140 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
190 X 130 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



1/4 PAG. ORIZZONTALE
1/4 PAGE HORIZONTAL
100 X 130 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
90 X 120 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



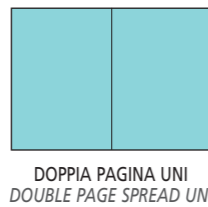
1/3 PAG. ORIZZONTALE
1/3 PAGE HORIZONTAL
210 X 105 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
181 X 90 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



1/3 PAG. VERTICALE
1/3 PAGE VERTICAL
80 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED
56 X 260 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



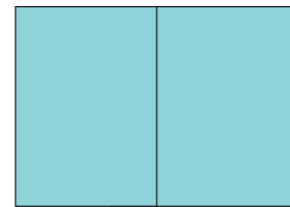
PAGINA INTERA
FULL PAGE
148 X 210
(VIVO + REFILI) / BLEED
125 X 190
(IN GABBIA) / TYPE AREA



DOPPIA PAGINA UNI
DOUBLE PAGE SPREAD UNI
296 X 210
(VIVO + REFILI) / BLEED
270 X 190
(IN GABBIA) / TYPE AREA

FORMATI PUBBLICITARI ADVERTISING FORMATS

EO NEWS



DOPPIA KING SIZE
DOUBLE KING SIZE PAGE
530 X 310 mm + REFILI / BLEED
500 X 290 mm IN GABBIA / TYPE AREA



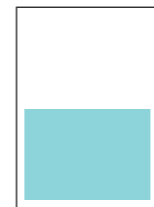
KING SIZE / KING SIZE
265 X 310 mm
+ REFILI / BLEED
245 X 290 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



UNI / UNI PAGE
203 X 230 mm
+ REFILI / BLEED
187 X 218 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



1/2 PAGINA VERTICALE
1/2 PAGE VERTICAL
132 X 310 mm
+ REFILI / BLEED
115 X 262 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



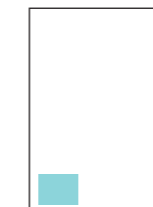
1/2 PAGINA ORIZZONTALE
1/2 PAGE HORIZONTAL
265 X 154 mm
+ REFILI / BLEED
235 X 137 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



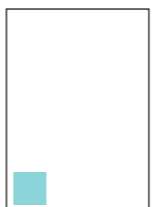
1/4 DI PAGINA / 1/4 PAGE
133 X 155 mm
+ REFILI / BLEED
115 X 137 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



JUNIOR / JUNIOR
154 X 201 mm
+ REFILI / BLEED
140 X 183 mm
IN GABBIA / TYPE AREA



MANCHETTE 1° COPERTINA
79 X 61 mm
MANCHETTE NEWS
91 X 61 mm

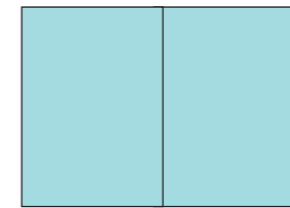


SPAZIO MERCATO
78 X 78 mm

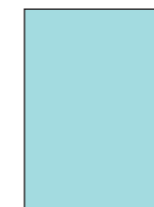
DOPPIA UNI: 406 X 218 mm IN GABBIA
PIEDINO PAG. 3: 235 X 78 mm IN GABBIA
1/3 DI PAGINA: 67 X 262 SOLO IN GABBIA

FORMATI PUBBLICITARI ADVERTISING FORMATS

AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE



DOPPIA PAGINA UNI
DOUBLE PAGE SPREAD UNI
420 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED



PAGINA INTERA
FULL PAGE
210 X 297 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED



1/2 PAG. VERTICALE
HALF PAGE VERTICAL
90 X 240 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA



1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE HORIZONTAL
180 X 125 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA

- IMMAGINE PRIMA DI COPERTINA 140 X 180 mm
SENZA REFILI
- FIRST COVER (IMAGE) 140 X 180 mm
BLEED

SPECIFICHE TECNICHE PER IL MATERIALE DI STAMPA

Formati: formato PDF ad alta risoluzione (300 dpi) ottimizzato per la stampa, più 3 mm per lato di refilo.

Supporti: CD, Server Sharepoint di Fiera Milano Editore
N.B: non inviare i file per posta elettronica.

Le lavorazioni di materiali non conformi alle specifiche sopra citate sia tecniche che di formato saranno fatturate forfettariamente (€ 50,00).

DETAILS FOR PRINTING MATERIAL

Formats: PDF format in highest resolution (300 dpi) ready for printing, with 3 mm of space at perimeter.

Supports: CD, Sharepoint Server of Fiera Milano Editore
N.B: do not send any file by e-mail.

Any modification of materials not conforming to the a.m. technical and size details will be invoiced at a forfait cost (€ 50,00).

Giuseppe De Gasperis

Sales Manager - Divisione Technology

Edizioni Fiera Milano SpA Divisione Technology

Viale Espinasse, 141

20156 Milano

Tel. +39 02 36 60 92 523

Fax +39 02 36 60 92 524

Mobile +39 34 87 14 67 48

E-mail: giuseppe.degasperis@fieramilanoeditore.it

Siti web: www.ilb2b.it - www.fieramilanoeditore.it

WORLDWIDE ADVERTISING sales offices

U.K. - SCANDINAVIA - NETHERLAND AND BELGIUM:

The Huson European Media - Gerry Rhoades-Brown

tel.: +44 1932 564999 - fax: +44 1932 564998

SWITZERLAND: Agentur Iff - Bernard Kull

tel.: +41 52 6330888 - fax: +41 52 6330899

GERMANY AND AUSTRIA: Media Agentur - Adela Ploner

tel.: +49 8131 3669920 - fax: +49 8131 3669929

USA: The Huson International Media USA - Ralph S. Lockwood

tel.: +1 408 8796666 - fax: +1 408 8796669

TAIWAN: Worldwide Services co. Ltd, Mr Robert Yu

tel.: +886-4-23251784 - fax: +886-4-23252967